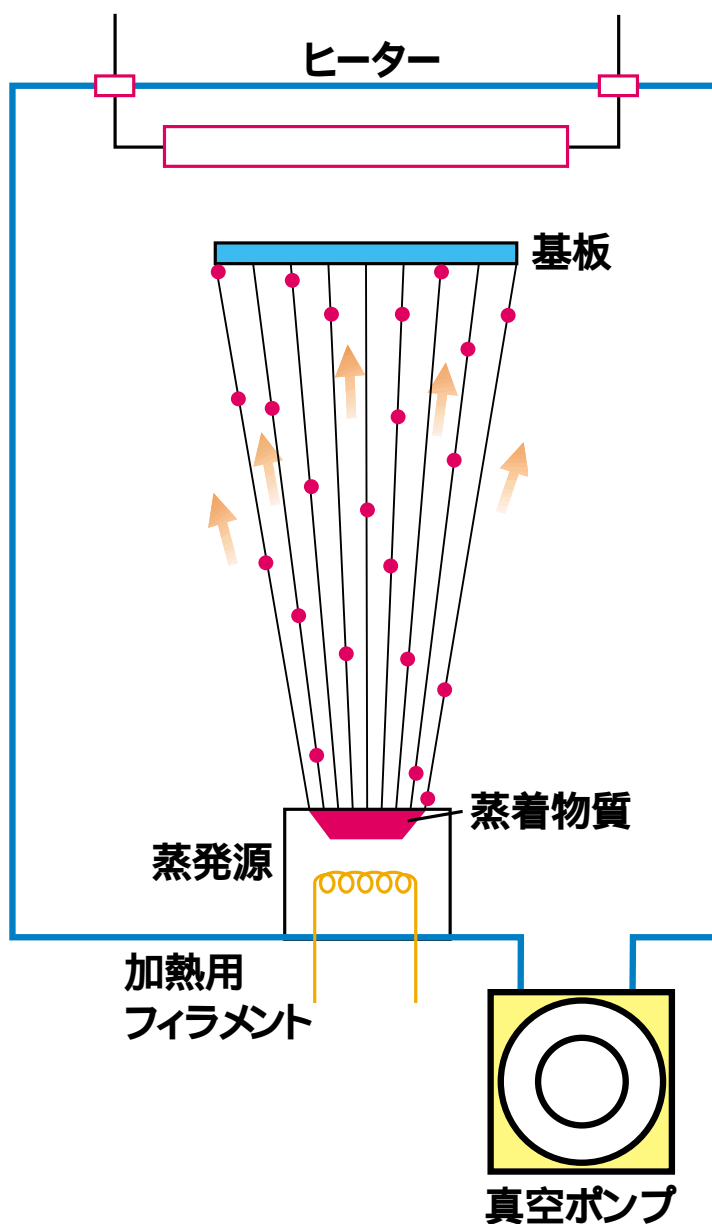


薄膜の作製法

真空蒸着



真空容器の中に蒸発源と基板を置いたもので、通常 $3 \times 10^{-2} \sim 10^{-4} \text{Pa}$ 程度の圧力下で成膜します。このときの平均自由行程は、数10cm～数10mくらいですから、蒸発した薄膜材料は、蒸発源から基板までほとんど衝突することなく到達します。